



記者発表資料
令和7年9月1日
国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第一班
担当 大泉、嶋貫
電話 022-211-2962
E-mail gbl@pref.miyagi.lg.jp

SEMICON Taiwan (半導体展示会) 2025 への県内企業出展について —9/10～12 台湾 台北市で開催—

宮城県では、「みやぎ半導体産業振興ビジョン」を策定し、今後も持続的な成長が見込まれる分野である半導体関連産業への県内企業の参入促進に取り組んでいます。

このたび、世界の半導体産業をリードする台湾で開催される世界最大規模の半導体展示会「SEMICON Taiwan 2025」に宮城県ブースを出展し、県内企業の取引創出を支援します。

1 SEMICON TAIWAN 2025

- (1) 開催期間 令和7年9月10日(水)～9月12日(金)
- (2) 会場 台北南港展覽館1&2 (TaiNEX 1&2) (台北市)
- (3) 主催 国際半導体製造装置材料協会 (SEMI)
- (4) 開催規模 出展者：1,100社、来場者：85,000人超
(2024年実績)



台北南港展覽館1&2外観



宮城県ブースイメージ

2 出展者 (県内事業者)

(1) 東北マイクロテック株式会社 (仙台市青葉区)

東北大学発のベンチャー企業。企業や研究機関の要望に応じて、従来一層だった半導体 IC チップを多層化することで、高性能・高機能・小型化・省電力化といった新しい機能を付加した複数層の IC チップを開発・製造します。

(2) ボールウェーブ株式会社 (仙台市青葉区)

J-Startup*にも選出されている東北大学発のベンチャー企業。半導体製造施設内において、不純物となる微量な水分の検知や、使用されるガスの状態に異常がないかどうかのモニタリングを高精度で行う各種検査機器を製造、販売します。

※J-Startup 世界と戦えるスタートアップ企業を作り出すことを目的に2018年に経済産業省・NEDO・ジェトロにより運営されている企業支援プロジェクト。

(3) 株式会社真壁技研 (仙台市宮城野区)

独自の「急凝固」技術により、半導体チップや半導体デバイスに用いられる高性能な粉末や薄帯などの材料を開発、製造、販売します。

(4) 3D Architech 合同会社 (仙台市青葉区)

独自開発した特殊な液体材料を光で三次元造形し金属化することで、高品質なデータセンター向け冷却部材など、複雑な形状で高性能な金属部品を、低コストで開発、製造します。